

# 46-7352 Economy Version

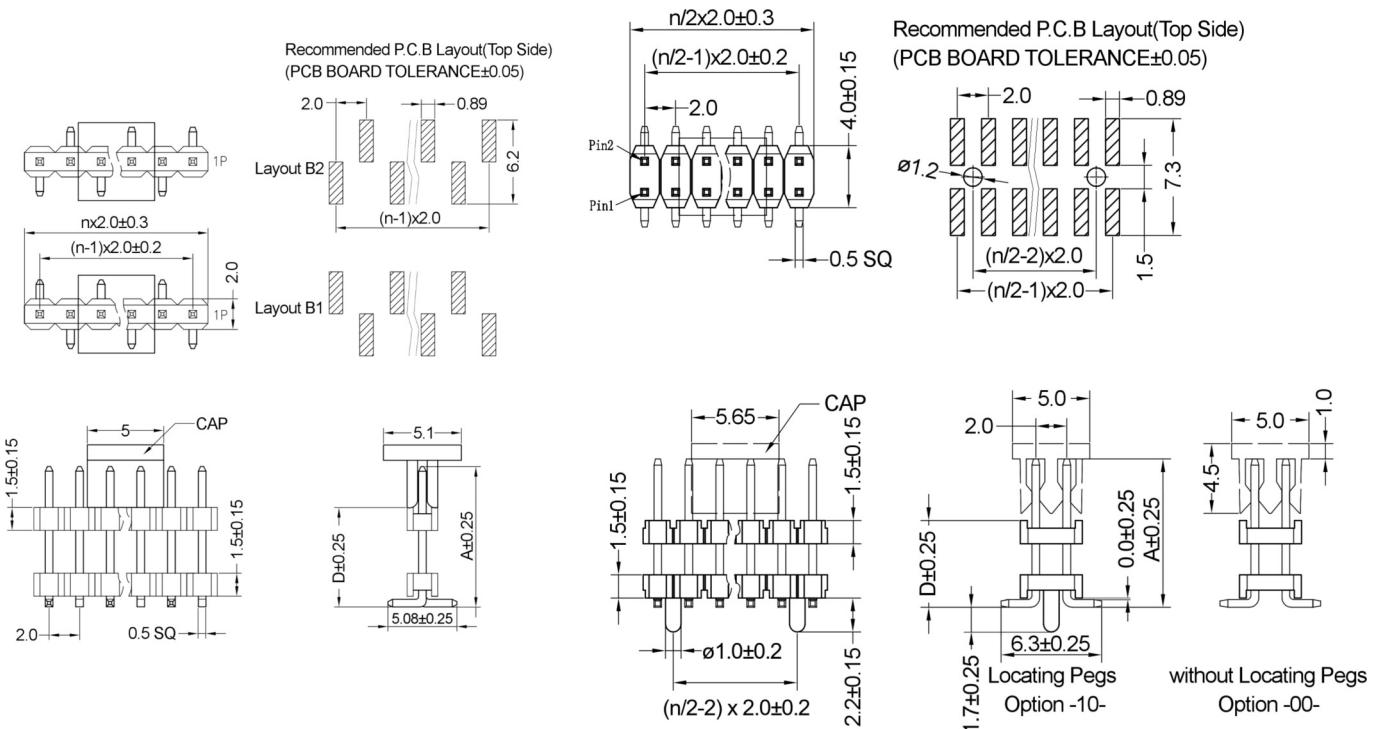
SMT-Sandwich-Stiftleisten RM 2,00mm, 1-/2-reihig  
SMT Dual Body Pin Headers, 2.00mm Pitch, Single/Double Row

## Technische Daten / Technical Data

|  |  |
|--|--|
| Isolierkörper<br><i>Insulator</i>                    | Thermoplast, nach UL94 V-0<br><i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i> |
| Kontaktmaterial<br><i>Contact Material</i>           | Kupferlegierung<br><i>Copper alloy</i>                             |
| Kontaktoberfläche<br><i>Contact Surface</i>          | Au über Ni<br><i>Au over Ni</i>                                    |
| Durchgangswiderstand<br><i>Contact Resistance</i>    | < 20 mΩ  |
| Isolationswiderstand<br><i>Insulation Resistance</i> | > 1000 MΩ  |
| Spannungsfestigkeit<br><i>Test Voltage</i>           | 500 V AC/DC  |
| Nennstrom<br><i>Current Rating</i>                   | 1,5 A  |
| Temperaturbereich<br><i>Temperature Range</i>        | -40 °C ... +105 °C   |
| Verarbeitung   | 230 °C für 30-60 Sekunden<br>(260 °C für 10 Sekunden)              |
| <i>Processing</i>                                    | 230 °C for 30-60 seconds<br>(260 °C for 10 seconds)                |



Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
**46-7450 46-7451 46-4160** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
*Please see ch. B for more*



| Series         | Contacts*   | Rows*  | Dimensions*  | Dim.*       | Plating                            | Locating Pegs*  | Packaging*         |
|----------------|---|--|--|-------------|------------------------------------|---|--------------------|
| <b>46-7352</b> | <b>30</b>   | <b>11</b>  | <b>01</b>  | <b>6,35</b> | <b>00</b>                          | <b>00</b>   | <b>PPST</b>        |
|                | 03-30 Einreihig<br><i>Single row</i><br>04-60 Zweireihig<br><i>Double row</i> | 11 Layout B1<br>12 Layout B2<br>20 Zweireihig<br><i>Double row</i> | 01 A=10,70mm<br>02 A=7,85mm<br>03 A=11,86mm<br>04 A=12,37mm<br>05 A=15,37mm<br>06 A=17,35mm<br>07 A=9,86mm<br>99- Kundenspez.<br><i>Customer-spec.</i> | D- [in mm]  | 00 Vergoldet<br><i>Gold plated</i> | 00 Ohne Pos.hilfen<br><i>W/o loc. pegs</i><br>10 Mit Pos.hilfen<br><i>(nur 2-reihig)</i><br><i>With loc. pegs</i><br><i>(double row only)</i> | ST<br>PPST<br>PPTR |

### Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*  
PPST In Stangen mit P&P-Pads / *In tubes with P&P-Pads*  
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* *This is an order example* -  
please replace by your specifications.

# Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert                        |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150 °C                          |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200 °C                          |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60 – 180s                       |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | untere Temperaturangabe [°C]    |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | laut Angabe im Datenblatt [sec] |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s                   |
| Höchsttemperatur $T_P$               | obere Temperaturangabe [°C]     |
| Dauer Höchsttemperatur               | laut Angabe im Datenblatt [sec] |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s                        |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$ | max. 8m                         |

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature                      | Key Values              |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150 °C                  |
| Maximum Temperatur $T_{Smax}$        | 200 °C                  |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60 – 180s               |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | Lower Temperature [°C]  |
| Duration above $T_L$                 | Acc. to datasheet [sec] |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s           |
| Peak Temperature $T_P$               | Upper Temperature [°C]  |
| Duration Peak Temperature            | Acc. to datasheet [sec] |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s                |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | max. 8min               |

